

DWG. NO. SD-53524-1364

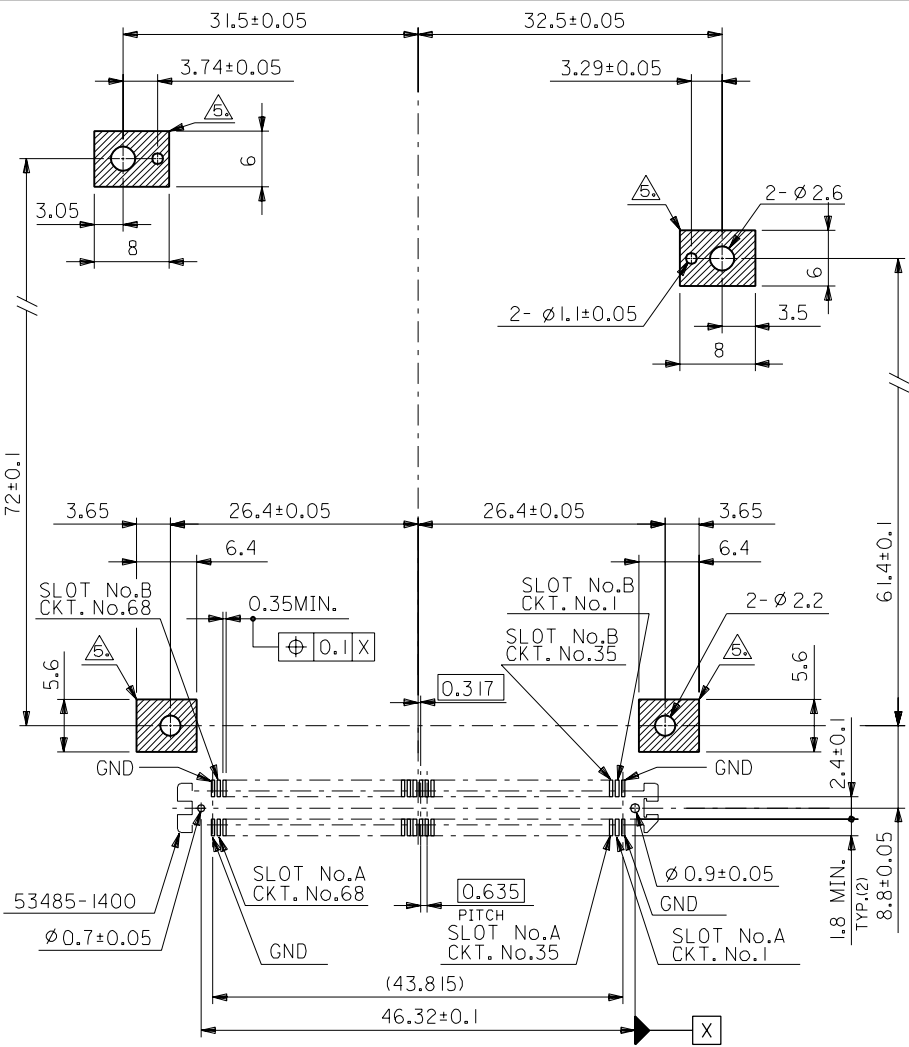
E

D

C

B

A



推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT

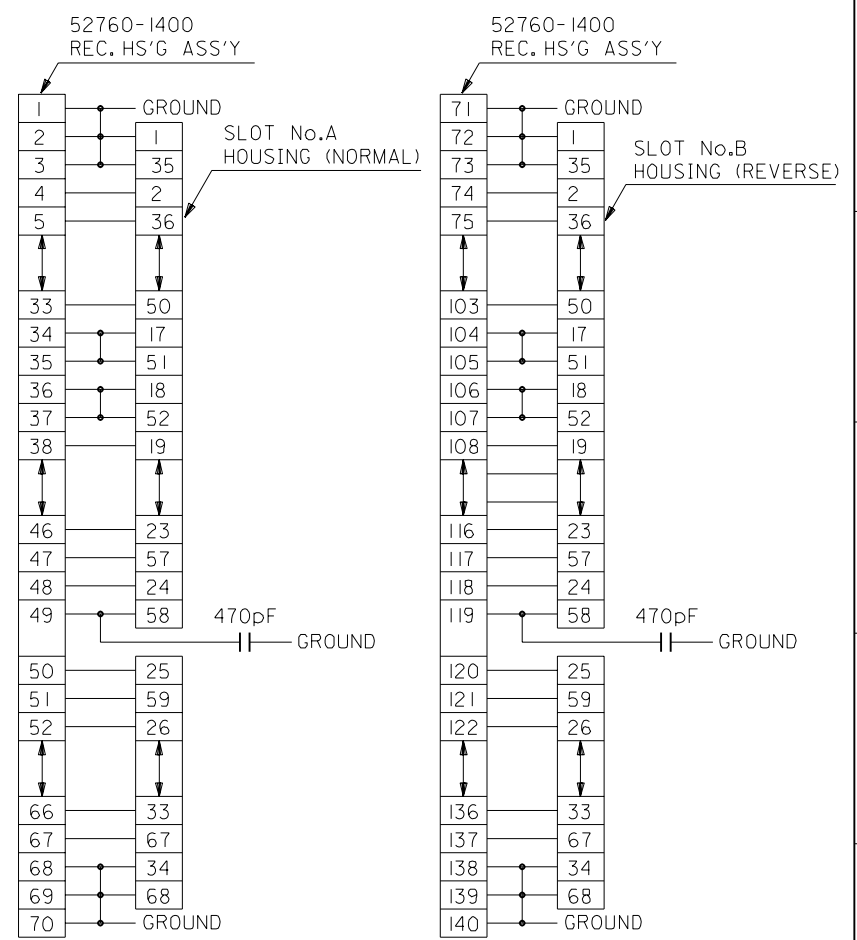


DIAGRAM A:
CIRCUIT ASSIGNMENT DWG.

材料 MATERIAL		SHEET 3 OF 3 参照 SEE SHEET 3 OF 3		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		SHEET 3 OF 3 参照 SEE SHEET 3 OF 3		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—		MEMORY CARD CONN. EJECT MECHANISM METAL SHELL TYPE	
DRAWN BY	CHK'D BY	DWG. NO.		SHEET 2 OF 3 REV	
A. Wata	M. Saito	SD-53524-1364		B	
DATE	SCALE	2 - 1			
94/10/21					

角度 ANGLE	+3°
30°以上 OVER	+0.3
10°以上 30°未満 UNDER	+0.25
未過 10° UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-OIC(032)MXJ-32

F

E

D

C

B

A

D14:1100061553524526.DGN

8

7

6

5

4

3

2

1

DWG. NO. SD-53524-1364

E

D

C
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

注)

NOTES
 △ ボタンストロークが 6.5mmの時、カード飛び出し量は (3.2mm)。
 ボタンストロークが 8.5mmの時、カード飛び出し量は (7mm)。
 WHEN BUTTON PUSH STROKE IS 6.5mm, CARD OUT BY (3.2mm).
 WHEN BUTTON PUSH STROKE IS 8.5mm, CARD OUT BY (7mm).

△ 接点部 CONTACT AREA 金めつき : 0.1 μmMIN.
 Au PLATING : 0.1 μmMIN.
 パラジウムニッケルめつき, Pd/Ni=80/20(%) 0.5 μmMIN.
 Pd-Ni PLATING, Pd/Ni=80:20(%) 0.5 μmMIN.

半田付(テ部) SOLDER TAIL AREA 半田めつき, Sn/Pb=90/10(%) 2.0 μmMIN.
 Sn-Pb PLATING, Sn/Pb=90/10(%) 2.0 μmMIN.
 下地めつき UNDERPLATING ニッケルめつき : 1.5 μmMIN.
 Ni PLATING : 1.5 μmMIN.

△ ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ 0.1 MAX.とする。
 PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1
 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.

△ ピン根元に適用する。
 THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.

△ 部品実装禁止範囲。
 NO PART TO BE MOUNTED IN THESE AREAS.
 △ 半田めつき, Sn/Pb=90/10(%) 3.0 μmMIN.
 Sn-Pb PLATING, Sn/Pb=90/10(%) 3.0 μmMIN.
 銅下地めつき : 1.0 μmMIN.
 Cu UNDER PLATING : 1.0 μmMIN.

No.	品名 NAME	材料 MATERIAL	仕上げ FINISH	個数 PIECE
1	HOUSING (NORMAL)	ガラス入り耐熱樹脂 UL94V-0 LCP G.F. UL94V-0 色 : 自然色 COLOR : NATURAL	—	1
2	HOUSING (REVERSE)	ガラス入り耐熱樹脂 UL94V-0 LCP G.F. UL94V-0 色 : 自然色 COLOR : NATURAL	—	1
3	PIN	りん青銅 PHOSPHOR BRONZE	NOTES △ 参照 SEE NOTES △	136
4	METAL SHELL (FOR LEFT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.254 STAINLESS STEEL t 0.254	—	1
5	METAL SHELL (FOR RIGHT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.254 STAINLESS STEEL t 0.254	—	1
6	BUTTON	ガラス入りポリエステル UL94V-0 PBT G.F. UL94V-0 色 : 青色 COLOR : BLUE	—	2
7	PUSH ROD (FOR LEFT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.8 STAINLESS STEEL t 0.8	—	1
8	PUSH ROD (FOR RIGHT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.8 STAINLESS STEEL t 0.8	—	1
9	LEVER (FOR LEFT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.4 STAINLESS STEEL t 0.4	—	1
10	LEVER (FOR RIGHT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.4 STAINLESS STEEL t 0.4	—	1
11	FRONT BRACKET	ステンレス鋼 t 0.4 STAINLESS STEEL t 0.4	—	2
12	REAR BRACKET	冷間圧延鋼板 (SPCC) t 0.5 COLD ROLLED CARBON STEEL SHEETS t 0.5	NOTES △ 参照 SEE NOTES △	2
13	PCB	ガラス布基材エポキシ樹脂 t 0.8 GLASS FABRIC BASE, EPOXY RESIN t 0.8	—	1
14	0.635 PITCH B-T0-B S/T REC. HS'G ASS'Y	SD-52760-***0 参照 SEE SD-52760-***0	—	1
15	INSULATION SHEET	ポリエステル t 50μm POLYESTER t 50μm	—	1
16	FIXED CAPACITORS	470pF SIZE: L6X0.8	—	2

F

E

D

C

B

A

材料 MATERIAL		表参照 SEE CHART		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		表参照 SEE CHART		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称 MEMORY CARD CONN. EJECT MECHANISM METAL SHELL TYPE	
被覆外径 INS. RANGE		—		DWG. NO. SHEET 3 OF 3 REV	
DRAWN BY A. Urita	CHK'D BY S. Saito	DATE 99/10/21	DATE 99/10/18	SD-53524-1364 B	
APP'D BY S. Saito		尺 度 SCALE NONE			

角度 ANGLE	+3°	
30 以上 OVER	+0.3	B
10 以上 30 未満 UNDER	+0.25	A
10 未満 UNDER	+0.2	O
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-OIC(032)MXJ-32

D14:11000615535241364.DGN